Ingénieur(e) Back-End / Assemblage H/F



Dotée d’une [expertise reconnue](https://www.youtube.com/watch?v=5rYF6lfxRRo) à l’international dans le domaine des capteurs et technologies MEMS sur-mesure et standards, [Tronics Microsystems](https://www.tronicsgroup.com/) fournit de nombreux marchés porteurs tels que l’industrie, l’aéronautique, les transports, la sécurité et le médical, contribuant ainsi à la transition vers de nouveaux modes d’intelligence dans le respect des enjeux sociétaux de demain.

Intégrés au sein de la Division dédiée aux capteurs du géant mondial [TDK Corporation](https://www.global.tdk.com/corp/en/news_center/tdk_channel/index.htm), nous sommes placés au cœur de sa stratégie de développement et vous invitons à contribuer activement à cette fabuleuse aventure.

C’est dans le cadre d’une accélération de notre dynamique de croissance que nous recherchons un(e) **Ingénieur(e) Back-End / Assemblage**. Vous serez le référent technique de sur plusieurs briques de fabrication et interviendrez sur celles-ci à différents niveaux :

Support de production, développement de procédés, produits ou moyens de production, industrialisation de procédés ou équipements

Bref, un rôle clé pour l’efficacité de notre outil de manufacturing !

**POURQUOI MOI ?**

De formation Bac+5, Ingénieur en Matériaux, Physique, Microélectronique ou Mécanique, vous avez un goût pour le travail de terrain (travail en salle blanche près de 60 % du temps) et êtes doté(e) d’une première expérience professionnelle.

Votre savoir-faire et savoir-être sont par ailleurs des éléments sur lesquels nous comptons tout particulièrement :

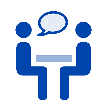
* Connaissance des procédés d’assemblage de précision en microélectronique ou horlogerie : collages, dispensing automatique (jetting, Auger), brasure AuSn Idéalement, spécialisation dans les technologies de packaging

microélectronique : Découpe de puce, report puce P&P, (colle, eutectique ou flip-chip), wire–bonding Au, fermeture brasée, marquage laser.

* Définition de boîtier céramique type LCC, J-Lead
* Etre familiarisé avec les outils d’amélioration et de fiabilisation des procédés (MSP/SPC, DOE, FMEA …)
* La pratique en CAO, conception d’outillage serait un plus.
* Capacité d’analyse, de synthèse et de reporting
* Force de proposition, réactivité et anticipation ; capacité à gérer plusieurs problématiques simultanément
* Bon relationnel, sens du service développé vis-à-vis du personnel de production ou des clients (internes + externes)
* Anglais écrit et parlé exigé.

Vous serez immergé(e) dans une équipe où confiance, respect, goût du défi et solidarité seront à l’honneur. Nous vous garantissons autonomie et polyvalence dans les responsabilités qui vous seront confiées, et avons à cœur de placer l’humain au cœur des challenges de l’entreprise. Alors rejoignez-nous dès maintenant !

* Poste basé à notre siège de Crolles (près de Grenoble)
* CDI, parce que nous parions sur vous !



**A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?**

Veuillez rentrer en contact dès maintenant avec Pierre ([pierre.descours@tronicsgroup.com](mailto:pierre.descours@tronicsgroup.com)) et Rosa ([rosa.pellet@tronicsgroup.com](mailto:rosa.pellet@tronicsgroup.com)).

A vous de jouer, nous avons hâte de vous rencontrer !